

鋳接タイプのコンポーネント操作法 02

湯まわり不良(なめられ)がある

金属のベースが含まれるパターンは、鋳造時の湯の温度を下げる傾向があり、通常より30～50度ほど焼却温度を上げます。

また、パターンレジンを大量に使用していると、ヒートショック法では埋没材を崩す恐れがありますので、ゆっくり温度を上げる必要があります。(730～750℃まで1時間程度で昇温させ、40分以上係留)

パターンは、金属ベース周囲を覆うようにし、調整が必要な部分は金属を鋳込んだ後、削合研磨します。

また、パターンが部分的に薄くなった(0.5mm以下)所は、エアVENT(φ1mm)を付与します。

鋳接の際に鋳込んだ金属がメタルベース内部に薄くはみ出してしまふ

表面活性剤は鋳接の時は絶対に使用しません。

分離材もとくにグリセリン系の場合は、埋没前にふき取るだけでなく、水洗いします。

少しでも被膜があればそこに金属が入り込むので、注意が必要です。

前述の材料を使用しない場合でも、露出した金属ベース内部をアルコールを浸み込ませた綿棒や綿球で十分にクリーンナップし、油分などを取り去れば、さらに安全です。

また、通常の鋳造よりも埋没材を膨張させないようにすることも有効です。たとえば混水比を少し高めたり、ライナーも薄目のものを選択して使用します。

スクリューアクセスホールに気泡が入る

埋没時、アクセスホール内に水を1～2滴入れ、アクセスホール上部から埋没材を静かに流して水を下に押し出してから、通常通りリング内に埋没材を満たします。

ただし気泡が入った場合は、鋳接後フィッシャーバーやラウンドバー等を利用し、丁寧に除去します。

(技術情報提供: (株)コアデンタルラボ横浜、UDB技工所)